

2023年(令和5年)7月24日(月曜日)



フェローテックが新工場

マレーシア・事業拡大に注力 ジョホール州

パワー半導体用 絶縁放熱基板製造

フェローテックホールディングスは、マレーシア南部にパワー半導体用絶縁放熱基板を製造する新工場を建設すると発表した。パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社の中国・江蘇富榮華半導体科技股份有限公司（FLH）の新工場として設立するもので、投資金額は6億9460万元（約137億円）。操業開始時期は2024年9月を予定する。

中国子会社に137億円投資

同社のパワー半導体事業は、電気自動車（EV）業界や太陽光発電を中心とする新興エネルギー業界などの発展と世界的電動化の動向の影響から、急速な拡大を遂げている。また、同社は世界的な大手顧客企業と長期的な戦略協力関係を築いており、これらの顧客側からの長期的発展を期待されている。

こうした中で、同社グループは中国の上海、東台、四川とパワー半導体用絶縁放熱基板の生産拠点を増やし、中国の3製造拠点の体制で顧客ニーズに 대응してきたが、昨今の経営環境の変化および大手顧客への対応の必

要性を考慮し、今回、マレーシア南部地区に新たな生産拠点を設置することを決めた。新工場建設により、成長著しいパワー半導体市場の需要を取り込み、事業拡大に注力する。

今回の製造拠点設置については、既存工場を買取した上で内装と改造を行うことで、立ち上げのスピードアップと投資金額の抑制を図る。また、現地で新工場の管理・運営を行う子会社を新たに設立する予定。

新工場の概要は、建設地はマレーシア南部ジョホール州。建屋延べ床面積は約3万4000平方メートル。投資金額は6億9460万元（約24億円）。

建設スケジュールは、建屋改造設計が今年7月、建屋改造開始が同年9月、機械設備設置開始が24年5月を予定し、同年9月から操業開始を予定。生産能力は、DCB基板が月産30万枚、AMB基板が月産20万枚の体制を整備する。

は6億9460万元